

Title (en)  
METHOD FOR CRIMPING A STONE

Title (de)  
VERFAHREN ZUM FASSEN EINES STEINS

Title (fr)  
PROCEDE DE SERTISSAGE D'UNE PIERRE

Publication  
**EP 3479720 A1 20190508 (FR)**

Application  
**EP 17200360 A 20171107**

Priority  
EP 17200360 A 20171107

Abstract (en)  
[origin: US2019133270A1] A method for assembling a stone on a setting support, the stone being cut to exhibit a table, a crown, a girdle and a pavilion. A substrate with a recess for the stone, the recess forming, between the substrate and the stone, a peripheral free space in the vicinity of the girdle and of the zones of the crown and of the pavilion contiguous to the girdle, the peripheral free space including a bottom having a conductive surface. Electroplating, in the peripheral free space, a metal layer in the vicinity of the girdle and of the zones of the crown and of the pavilion contiguous to the girdle, so as to confine the girdle in the metal layer to form, around the girdle, the setting support. The stone and its setting support are released from the substrate.

Abstract (fr)  
L'invention se rapporte à un procédé d'assemblage d'une pierre (1) sur un support de fixation (2), ladite pierre (1) étant taillée pour présenter une table, une couronne, un rondiste (5) et une culasse, ledit procédé d'assemblage comportant les étapes suivantes: a) se munir d'un substrat (8) comportant au moins un logement (10) dans lequel est positionnée ladite pierre (1), ledit logement (10) étant agencé pour former entre le substrat (8) et ladite pierre (1) un espace libre périphérique (12) au moins au niveau du rondiste (5) et de zones (4a, 6a) de la couronne (4) et de la culasse (6) contiguës au rondiste (5), ledit espace libre périphérique (12) comprenant un fond (14) présentant une surface conductrice (16) b) déposer par voie galvanique dans ledit espace libre périphérique (12) une couche métallique (36) au moins au niveau du rondiste (5) et des zones (4a, 6a) de la couronne (4) et de la culasse (6) contiguës au rondiste (5) de manière à emprisonner ledit rondiste (5) dans ladite couche métallique (36) pour former, au moins sensiblement autour du rondiste (5) de la pierre (1), ledit support de fixation (2) c) libérer ladite pierre (1) et son support de fixation (2) du substrat (8). L'invention concerne également un procédé de sertissage sur un élément d'une pièce d'horlogerie ou de bijouterie d'une pierre et de son support de fixation obtenus selon ledit procédé d'assemblage.

IPC 8 full level  
**A44C 17/04** (2006.01); **C25D 7/00** (2006.01); **G04B 47/04** (2006.01)

CPC (source: EP US)  
**A44C 17/04** (2013.01 - EP US); **A44C 27/00** (2013.01 - US); **C25D 1/003** (2013.01 - EP US); **C25D 5/022** (2013.01 - EP US); **C25D 7/005** (2013.01 - EP US); **G04B 47/042** (2013.01 - EP US)

Citation (applicant)  
DI BARI G.A.: "Electroplating Engineering Handbook", 1984, VAN NOSTRAND REINHOLD COMPAGNY INC., article "electroforming"

Citation (search report)  
• [X] US 2008066310 A1 20080320 - PANG SIU CHUNG [CN]  
• [XI] EP 0620987 A1 19941026 - BREUNING FRANZ FA [DE]  
• [X] JP H06240487 A 19940830 - YAMADA KK

Cited by  
US11547187B2; EP3771359A1

Designated contracting state (EPC)  
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)  
BA ME

DOCDB simple family (publication)  
**EP 3479720 A1 20190508**; **EP 3479720 B1 20200325**; CN 109744668 A 20190514; CN 109744668 B 20201106; JP 2019084344 A 20190606; JP 6703582 B2 20200603; US 10743625 B2 20200818; US 2019133270 A1 20190509

DOCDB simple family (application)  
**EP 17200360 A 20171107**; CN 201811255717 A 20181026; JP 2018189738 A 20181005; US 201816140852 A 20180925